

リフロー工程での“基板の反り”、予測できていますか？

Simcenter Flotherm-Abaqusの連携による“基板の反り”解析ソリューション



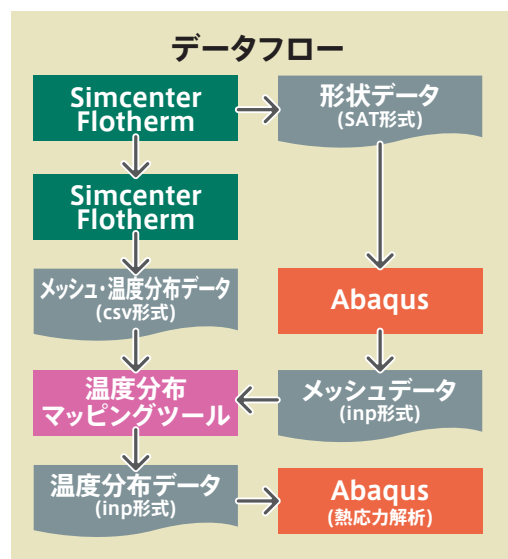
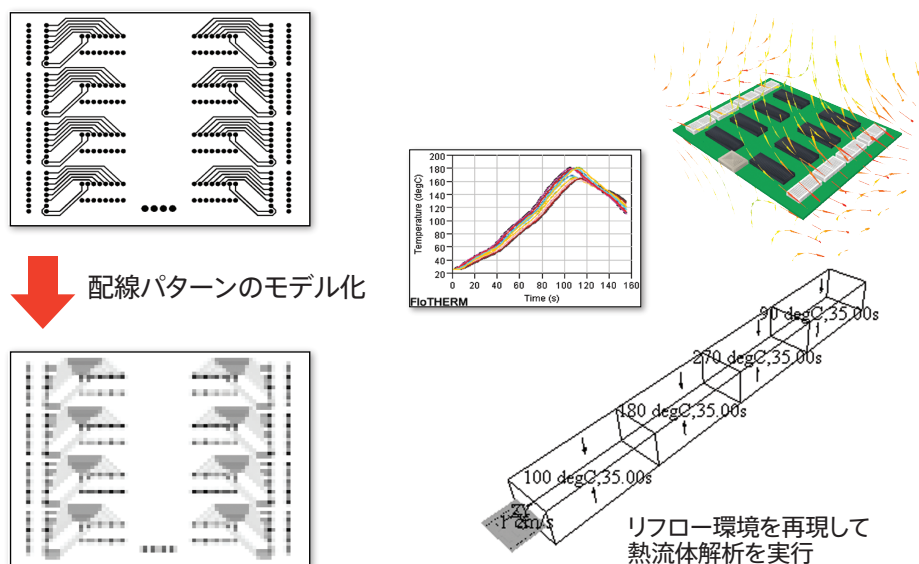
リフロー工程でのプリント配線基板の反りは、基板内温度分布と配線パターンにより大きく変化するもの。

配線パターンまで考慮したSimcenter Flothermによる熱流体解析とAbaqusによる熱応力解析の連携で、リフロー工程における基板の反りの予測を可能にします！

Simcenter FlothermとAbaqusの連携による解析イメージ

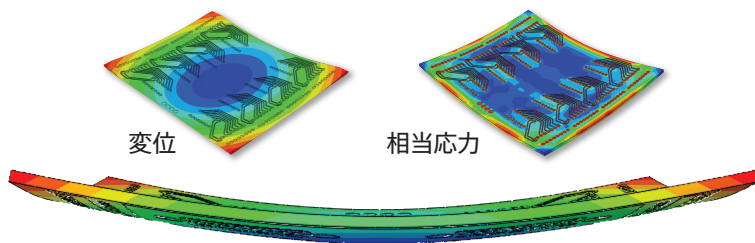
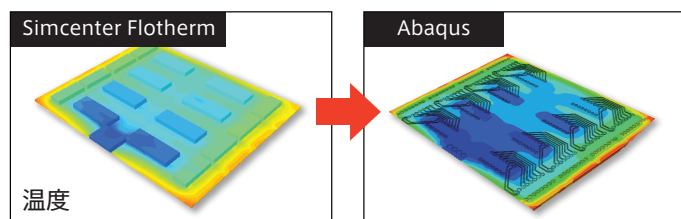
1 リフロー工程でのSimcenter Flothermによる熱流体解析

基板CADデータからインポートした配線パターンを、Simcenter Flothermの配線パターンのモデル化機能により等価熱伝導率分布に置き換え、モデル化し、フロー環境下で熱流体解析をおこないます。



2 Abaqusによる熱応力解析から基板反りを予測

Simcenter Flothermで解析した基板温度分布データを、Abaqusのメッシュデータにマッピングし、熱応力解析から基板の反りを予測します。



お問い合わせはこちらまで

Simcenter Flotherm販売代理店



株式会社 IDAJ

〒220-8137

横浜市西区みなとみらい2-2-1-1 横浜ランドマークタワー37F

TEL : 045-683-1990

FAX : 045-683-1999

E-Mail : info@idaj.co.jp

URL : http://www.idaj.co.jp/

Simcenter Flotherm開発元

Simcenter Flothermは、Siemens社により開発されました。本文中に記載の会社名、製品名、サービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標です。